附件5：最佳产业生态协同奖申报表

**最佳产业生态协同奖申报表**

说明：该奖项授予支持汽车芯片设计和应用的各类上下游企业，如芯片设计工具EDA企业、芯片IP企业、晶圆代工企业、封测企业、检测认证机构、高校科研院所、各类服务平台等。该企业应在推动我国汽车芯片产业发展、构建产业生态、支持自主芯片上车应用等领域做出重要贡献。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本信息** | | |
| **基本情况** | 行业影响力及认可度 | 自主描述。描述参选单位在行业内的影响力和认可度 |
| 技术能力 | 自主描述。描述参选单位在行业内的技术实力。（技术能力、市场能力和生态建设能力，参选单位可按实际情况选择一项或多项填写。） |
| 市场能力 | 自主描述。描述参选单位的相关业务在行业内的市场占比和存在价值 |
| 生态建设能力 | 自主描述。描述参选单位的生态建设能力，如生态模式、合作伙伴、解决行业问题的方案及能力等 |
| **过去3年对汽车芯片行业的主要贡献** | | |
| **主要贡献** | 主要贡献描述 | 自主描述 |
| 投入资金/人力 | 自主描述 |
| 贡献产生的意义 | 自主描述。是都对于行业发展起到关键作用，产生了广泛而深远的影响 |
| 贡献产生的实际结果 | 自主描述。是否解决了行业发展中遇到的问题，行业收益群体广泛，推动了行业的发展 |
| 行业对其贡献的认可度 | 自主描述 |
| **联系人信息** | | |
| **联系人** | 联系人姓名及职务 |  |
| 手机号 |  |
| E-mail |  |
| 地址 |  |
| **参赛承诺** | | |
| 本单位自愿参加2022年中国汽车芯片创新大赛，并已详细阅读了解赛事规则、须知及要求，能自觉遵守赛事规程和约定相关事项。参赛作品符合国家法律法规、国家产业政策，不存在所有权、知识产权等权益争议。存在相关权益争议的，自愿承担由此引发的一切法律责任。保证所提交的参赛资料真实、准确、合法和完整，承认大赛举办方资格审查、材料复核和作品评审的结果。如存在虚假信息，愿意接受大赛举办方的相关处理决定，自行承担由此产生的法律责任。  授予赛事举办方自参赛作品提交之日起两年内，以赛事品牌宣传为目的，以各种方式和方法使用参赛团队及所提供参赛作品的不涉及核心技术机密的必要信息，包括但不限于电视、报刊、杂志、广播及互联网等。赛事举办方对参赛团队提供的相关信息履行必要保密措施，但在评审过程中因不可抗力造成信息泄露的，赛事举办方不承担任何法律责任。  本承诺书真实可靠，承诺人自愿签订并严格、善意履行本承诺书，其中承诺事项自承诺书生效时即对各承诺人产生法律约束力，本承诺书为不可撤销承诺书，承诺人无权撤回本承诺书中的各项承诺事项。若由于承诺人有任意违法、违规、违反本届大赛相关要求或违反本承诺书的行为而造成大赛举办方损失的，赛事举办方有权取消参赛资格，由承诺人负责全额赔偿。  授权代表签字：  单位盖章  提交日期：    年   月   日 | | |

说明：参赛承诺（即签章页）可由申报团队各成员单位分别签字盖章后，交由牵头申报单位统一汇总提交。